

センシング技術応用セミナー

～いよいよ実用化段階！～

AIを用いた応用技術の動向と展望



※ 講演はOnlineでも配信します。また講演番号左に*がつく講演は、Online講演が確定しています。

【開会挨拶】センシング技術応用研究会 会長 筒井 博司 氏 (10:00~10:05)

【講演】
1. 「機械学習とその応用」 (10:05~10:55)
京都大学 情報学研究科 教授 鹿島 久嗣 氏

本講演では、現在の人工知能ブームを支える基盤技術である機械学習の基本的な考え方やアプローチを紹介するとともに、その様々な応用について紹介するとともに、グラフ深層学習や集合知などの最近の話題について触れます。

2. 「産業分野における高精度計算科学技術を駆使した機能材料の研究開発とその課題」 (11:00~11:50)
株式会社 アーク・イノベーション、AIMaP ディレクター 檜貝 信一 氏
センシング技術を支える機能材料の研究開発は、現在、変革の時期にあり、計算科学およびデータ科学技術には大きな期待が寄せられていますが、多くの課題も顕在化しています。本講演では、講演者の上技術への取組を紹介すると共に、これらの課題を上げ議論します。

--- 昼休み --- (11:50~12:50)

* 3. 「実世界で人間と相互理解し協働する人工知能」(オンライン講演) (12:50~13:40)
国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター 人工知能研究センター 総括研究主幹 麻生 英樹 氏

社会の多くの分野で人工知能技術が使われるようになってきました。そうした人工知能技術のこれまでの発展と最近の応用事例について紹介します。さらに、実世界の中により一層浸透させてゆくための技術開発の方向性や研究開発事例、センシング技術と組み合わせた今後の展望、についてもご紹介します。

* 4. 「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」 (13:45~14:35)
キオクシア株式会社 デジタルプロセスイノベーションセンター 技監 折原 良平 氏
半導体製造において、オペレーションの自動化、生産規模の拡大、品質確保によるコストの削減と競争力の強化が課題となります。キオクシアの製造現場では、自動化生産ラインから大量のデータを収集し、AI技術を適用して品質監視と課題解決を行なう情報システムを活用し、高い品質を確保しています。しかし、製造現場には、大量のデータとAI技術を活用してコスト削減と利益拡大を図る余地がまだ残されています。本講演では、これまでの成果と今後への期待を紹介します。

--- 休憩 --- (14:35~14:45)

5. 「スマートセル AI×バイオが拓く未来の姿」 (14:45~15:15)
経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課 課長 日村 健二 氏
近年、世界的にバイオエコノミーの潮流への期待が醸成されつつあります。その大きな推進力となっているのがバイオ技術とデジタル技術の融合であり、「欲しい機能」を合理的にデザインした「スマートセル」による産業創出の可能性や、バイオエコノミーの実現に向けた動きをご紹介します。

6. 「AI技術の医療分野への応用」 (15:20~16:10)
株式会社 島津製作所 基盤技術研究所 AIソリューションユニット 画像グループ
グループ長 森田 尚孝 氏
AI技術の発展は著しく、超高齢化社会の医療にもAI技術が大きく貢献することが期待されています。本講演では、AIを用いたデータ処理技術の医療応用に関して、弊社での取り組み事例をご紹介します。

*7. 製品紹介 「スパースモデリングを利用した産業・医療分野向けAIソリューション」(オンライン講演) (16:15~16:45)
株式会社HACARUS データサイエンティスト 岩尾 快彦 氏
スパースモデリングは、少量のデータからの特徴量抽出にすぐれ、解釈性の高い学習と推論を行える技術です。スパースモデリング技術をAIに応用した産業・医療分野への弊社の取り組みについて紹介します。

日時：2020年10月15日(木) 10:00~16:45

場所：大阪産業創造館 6階 会議室E

■所在地

〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4-5

URL : <https://www.sansokan.jp/map/>

■アクセス

大阪地下鉄「堺筋本町」下車徒歩10分

主催：センシング技術応用研究会
(一社)大阪府技術協会

後援：(地独)大阪産業技術研究所



■新型コロナウイルス感染防止のため、Onlineでのご参加も可能です。会場の定員は、3密を防ぐため通常の1/3となっています。なお、今後の状況変化によっては、Online講演が増えたり、Online参加のみとなる可能性もありますのでご了承ください。

参加のおすすめ

人工知能(AI)技術の著しい進展により広い分野での活用が始まっており、どのような可能性があるのか、どう活用するのがあらゆる分野で重要なテーマとなっています。本セミナーでは、AI技術やデータサイエンスに関する基調講演と、医療、ものづくり、バイオなどの様々な分野での応用事例についての講演を基に、AI技術の最新動向と今後の展望を考える機会を提供します。

■参加費(テキスト代・消費税を含む)

主催・協賛団体会員：8,000円、一般：10,000円、学生：3,000円

*参加者のご氏名、ご所属、住所、電話、メールアドレス、ご希望の参加形態(現地/Online)、Online参加をご希望の場合はweb招待メールの送信先アドレス、(主催/協賛/一般/学生)をご記入の上、申し込み先にメールまたはFAXでお申し込みください。

協賛団体(予定)：(一社)電気学会、(一社)電子情報通信学会、(一社)次世代センサ協議会、(一社)日本機械学会、ニューセラミックス懇話会、(公社)応用物理学会、(一社)KEC関西電子工業振興センター、(一財)大阪科学技術センター、他12学協会

※協賛団体の詳細につきましては、センシング技術応用研究会事務局にお問い合わせ下さい。

■定員(先着順)：30名(現地会場)・80名(オンライン) ■申し込み締め切り：10月12日(月)

■申し込み・問い合わせ先：センシング技術応用研究会

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-7-1 大阪産業技術研究所 和泉センター内

TEL : 0725-51-2534 FAX : 0725-51-2597

E-mail : ssstj@dantai.tri-osaka.jp URL : <http://tri-osaka.jp/dantai/ssstj/>